

	題目	著者	出典
1. 雑誌掲載論文(査読のあるもの)	RoHS対応鉛フリーはんだ実装の現状と課題 Sn-Ag-Cu鉛フリーはんだへのNi, Ge添加効果	下田将義, 渡邊裕彦, 日高昇	金属Vol. 79 (2009年5月号), pp.423-429
	Sn-Ag系はんだ材の局所力学特性に及ぼす微視組織および微量添加元素の影響	下田将義, 山下満男, 波田哲紀, 坂上賢一, 小川武史	日本材料学会学術講演会講演論文集 (2009), pp.137-138
2. 国際会議論文(査読のあるもの)	The Effect of Ni,Ge Elements on Microstructure and Mechanical Properties of Sn-Ag-Cu Solders	下田将義, 日高昇, 山下満男, 坂上賢一, 小川武史	11th Electronics Packaging Technology Conference
	Effect of Interfacial Reaction in Sn-Ag-Cu Solder Alloy Adding Ni	渡邊裕彦, 下田将義, 日高昇, 莊司郁夫	8th International Conference on Fracture and Strength of Solids
3. 国内会議論文(査読のあるもの)	鉛フリーはんだの引張特性・時効特性・熱疲労特性について	下田将義, 松村慶一, 仲西恒雄	8th Symposium on Microjoining and assembly Technology in Electronics (2002), pp.215-220
	鉛フリーはんだの時効による強度および組織の変化	下田将義, 松村慶一, 仲西恒雄	9th Symposium on Microjoining and assembly Technology in Electronics (2003), pp.325-330
	はんだの応力ひずみ構成方程式作成の試み	下田将義, 小野眞裕, 松村慶一, 仲西恒雄	10th Symposium on Microjoining and assembly Technology in Electronics (2004), pp.47-50
	In薄膜によるCu/Cu直接接合の界面特性に関する研究	谷口克己, 下田将義, 片倉英明, 後藤友彰	10th Symposium on Microjoining and assembly Technology in Electronics (2004), pp.225-230
	Sn-Ag-Cu系鉛フリーはんだのクリープ特性における微量添加元素の効果	長野恵, 日高昇, 下田将義, 渡邊裕彦	11th Symposium on Microjoining and assembly Technology in Electronics (2005), pp.171-176
	Sn-Ag-Cu-Ni-Ge鉛フリーはんだの機械的特性と組織の関係	長野恵, 日高昇, 下田将義, 小野眞裕	エレクトロニクス実装学会 (2005), pp.495-501
	Sn-Ag-Cu-Ni-Ge系鉛フリーはんだ接合部のクリープ挙動	日高昇, 渡邊裕彦, 下田将義, 小野眞裕, 長野恵	12th Symposium on Microjoining and assembly Technology in Electronics (2006), pp.235-238
	Sn-Ag-Cu系鉛フリーはんだのクリープ特性における微量添加元素の影響	長野恵, 日高昇, 渡邊裕彦, 下田将義, 小野眞裕	エレクトロニクス実装学会 (2006), pp.171-179
	Sn-Ag-Cu-Ni-Geはんだ接合界面の反応層形成について	渡邊裕彦, 下田将義, 莊司郁夫, 大澤勤	14th Symposium on Microjoining and assembly Technology in Electronics (2008), pp.83-88
	静電容量型ジャイロセンサの開発	下田将義, 松下浩二, 石河範明, 熊田貴夫, 鈴木健	15th Symposium on Microjoining and assembly Technology in Electronics (2009), pp.273-276
4. 国内会議論文(査読なし)	モンテカルロ法によるはんだ付け不良率の推定	金子公寿, 岸郁朗, 鴨志田孝, 下田将義, 松村慶一	第16回 エレクトロニクス実装学術講演大会 (2002)
	In薄膜によるCu/Cu直接接合プロセス	谷口克己, 下田将義, 後藤友彰, 山田利典, 安田清和, 藤本公三	第13回 マイクロエレクトロニクスシンポジウム論文集 (2003), pp.172-175
	Sn-Ag-Cu鉛フリーはんだへのNi添加の影響	下田将義, 渡邊裕彦, 塩川国夫	はんだ・微細接合部会 発足記念シンポジウム 2008鉛フリー実装技術～成熟期の鉛フリー実装技術と最近の優位化状況～
5. 弊社紀要類	はんだ付けのメカニズムと解析技術	渡邊裕彦, 下田将義, 金子公寿	富士時報 (2002), pp.516-519